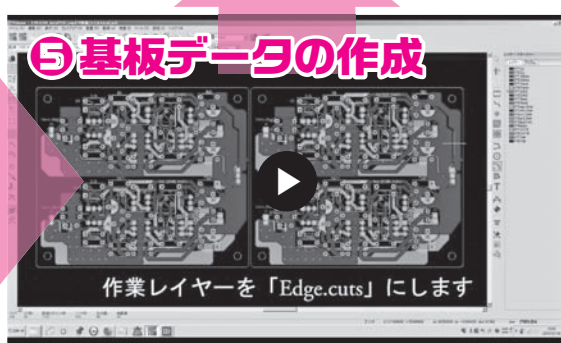
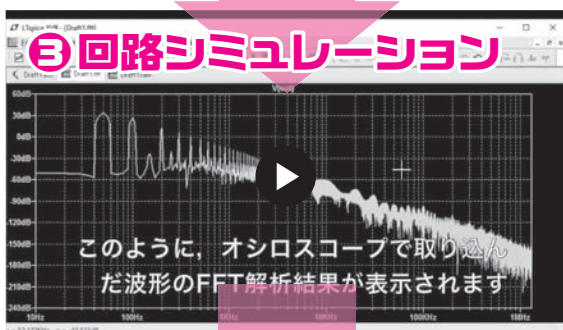
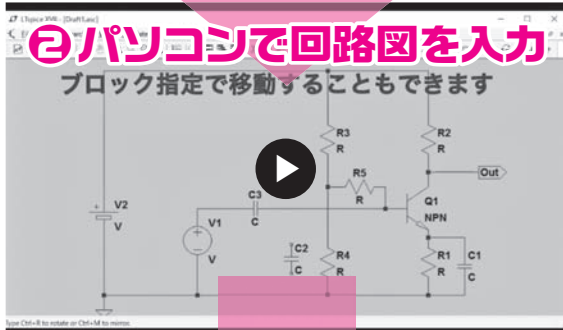


イントロダクション

オールビデオ学習！ Step by Step 電子回路の作り方 世界共通の基本

回路図の描き方、シミュレーション、基板データの作り方から測定器の使い方まで



全150本! DVD-ROM収録のお手本ムービー一覧

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| STEP1: 回路図の描き方 | | 76 | プラグの組み立て方① ビニール電線の場合 |
| 1 | 回路図の描き方① 回路のアイデア出し NEW | 77 | プラグの組み立て方② 同軸ケーブルの場合 |
| 2 | 回路図の描き方② アナログ回路編 NEW | 電線や同軸ケーブル | |
| 3 | 回路図の描き方③ デジタル回路編 NEW | 78 | 同軸ケーブルの取り付け方 |
| 4 | 回路図の描き方④ 部品の極性 NEW | 79 | ビニール電線の取り付け方① 予備はんだ |
| STEP2: 電子回路シミュレーション | | 80 | ビニール電線の取り付け方② 電線同士 |
| LTSpice基本操作編 | | 81 | ビニール電線の取り付け方③ 基板 |
| 5 | 回路図を入力する | 82 | ビニール電線の取り付け方④ ICの端子 |
| 6 | 回路の条件を設定する | 83 | 被覆なしリード線(ジャンパ・ワイヤ)の取り付け方 |
| 7 | シミュレーションを実行して結果を確認する | 84 | ICへのジャンパ配線の取り付け方 |
| 8 | 波形ビューアで解析結果を確認する | はんだ除去 | |
| 9 | 周波数特性を調べる | 85 | 熱不足によるもはんだの例 |
| 10 | 直流特性を調べる | 86 | 盛り過ぎたはんだの取り除き方 |
| 11 | 部品メーカーのウェブ・サイトからダウンロードしたモデルの登録 | 87 | QFP ICのはんだ付けとブリッジ修正 |
| 12 | トラ技オリジナル・ライブラリの登録 | 88 | ブリッジ修正 |
| 13 | 部品の定数を変更して傾向や最適な値を調べる | 89 | 熱し過ぎ(400℃ 5秒)のはんだの取り除き方 |
| 14 | 音声WAVファイルを入力して出力の音を聞く | リード部品の取り外し | |
| 15 | オシロスコープの生データを入力し信号源にして回路解析 | 90 | 足が曲がるタイプの取り外し方 |
| 16 | LTSpiceのサンプル回路ファイルのシミュレーションを実行する | 91 | 足が曲がらないタイプの取り外し方 |
| 17 | 日本語表示機能を使う | チップ部品取り外し | |
| 18 | 動作点の電圧を表示する | 92 | チップ抵抗1608の取り外し方 |
| 19 | 回路図/波形ビューアの色変更などのカスタマイズ機能を使う | 93 | チップ抵抗1005の取り外し方 |
| 20 | シンボル・ファイルの作り方とライブラリの登録 NEW | 94 | チップ・タンタル・コンデンサの取り外し方 |
| LTSpice実践編 | | 半導体取り外し | |
| 21 | waveファイルのFFT解析① スペクトラム表示 | 95 | 放熱板付き半導体の取り外し方 |
| 22 | waveファイルのFFT解析② 回路ファイルの作り方と基本設定 | 96 | リード・タイプICの取り外し方 |
| 23 | waveファイルのFFT解析③ FFTの詳細設定 | 97 | 表面実装タイプICの取り外し方 |
| 27 | 半導体デバイス・モデルの品種変更コマンド[AKO]の使い方 | 98 | 裏に放熱板がある表面実装タイプICの取り外し方 |
| 30 | 等間隔時間をもつ生データの出力方法 | 特殊部品の取り外し | |
| 24 | 数式モデル「ビヘイビア」の使い方① BRの例題回路1 | 99 | ピン・ヘッダの取り外し方 |
| 25 | 数式モデル「ビヘイビア」の使い方② BRの例題回路2 | 100 | 小型半固定抵抗の取り外し方① 片面基板 |
| 26 | 数式モデル「ビヘイビア」の使い方③ ビヘイビア電力負荷BP | 101 | 小型半固定抵抗の取り外し方② 両面基板 |
| 28 | コアあり非線形インダクタのモデル化① tanh(x) | 102 | ポリウム線の取り外し方 |
| 29 | コアあり非線形インダクタのモデル化② B-Hカーブ | 103 | 表面実装タイプのネットワーク抵抗の取り外し方 |
| STEP3: プリント基板データの作り方と発注 | | 104 | コネクタの取り外し |
| KiCad5基本操作編 | | 105 | リード・タイプのコネクタの取り外し方 |
| 31 | インストール手順 | 106 | 表面実装タイプのコネクタの取り外し方 |
| 32 | 回路図作成 | プリント・パターンの切り貼り術 | |
| 33 | コンポーネントとフットプリントの関連付けとネットリストの出力 | 107 | 細かいプリント・パターンをカットする |
| 34 | プリント・パターンの作成 | 108 | 太いプリント・パターンをカットする |
| 35 | ガーバ・データの出力 | 109 | 2点間をジャンパ線でつなぐ |
| 電子部品やプリント基板の発注 | | 110 | 持ち上げたICの端子へジャンパ線をつける |
| 36 | Digi-keyによる電子部品の発注 NEW | 111 | チップ抵抗を並列に接続する方法 |
| 37 | 基板製造業者への発注 | 112 | チップ抵抗を直列に接続する方法 |
| 38 | 部品実装の依頼 | 113 | 取り付けパッドのない場所にコンデンサを追加する |
| KiCad5実践編 | | はんだ付けで使う道具 | |
| 39 | SPICEシミュレーションの方法 | 114 | ステーション型はんだこて① 温度調節&表示機能付き |
| 40 | ICのSPICEモデルの読み込み方法 | 115 | ステーション型はんだこて② 温度調節機能付き |
| 41 | LTSpiceとの連携 | 116 | 一体型はんだこて(温度調整機能付き) |
| 42 | Eagleプロジェクトのインポート機能 | 117 | こて先の種類 |
| 43 | 基板エディタの表裏反転機能 | 118 | こて先の選び方 |
| 44 | 3D CADデータ形式STEPの入出力機能 | 119 | こて先のメンテナンス方法 |
| 45 | KiCad 5のライブラリ更新方法 | 120 | こて先の温度管理方法① |
| 46 | オートルータの使い方 | 121 | こて先の温度管理方法② |
| 47 | 新規コンポーネントとフットプリントの作り方 | 122 | はんだが綺麗に流れるようにするフラックス |
| 48 | 基板の面付け NEW | 123 | フラックス洗浄用品 |
| 49 | 既存の部品ライブラリの変更方法 NEW | 124 | はんだ除去用品 |
| STEP4: はんだ付けのテクニック | | 125 | 微小部品を取り扱うピンセット |
| リード付き部品 | | 126 | 切断や加工を行うラジオペンチ |
| 50 | リードのカット | 127 | 拡大用ルーペ |
| 51 | 足が曲がるタイプの取り付け方① 炭素皮膜抵抗 | はんだ付けの基礎知識 | |
| 52 | 足が曲がるタイプの取り付け方② 小さいランドの場合 | 128 | はじめ方と終わり方 |
| 53 | 足が曲がるタイプの取り付け方③ リード線を後でカットする場合 | 129 | 溶け方と固まり方 |
| 54 | こて先が汚いと抵抗の取り付けに失敗する | 130 | 温度と溶け方 |
| 55 | こて先をクリーニングするとうまく取り付けられる | 131 | 確実にくっつけるコツ |
| 56 | 足が曲がらないタイプの取り付け方 | STEP5: 電子回路の実験と測定 | |
| チップ部品 | | テスタ/オシロスコープ/プローブの正しい使い方 | |
| 57 | 取り付け方① チップ抵抗2012 | 132 | プローブの役割 |
| 58 | 取り付け方② チップ抵抗1608 | 133 | オシロスコープの選び方 |
| 59 | 熱容量の大きなランドの場合① はんだこてによる方法 | 134 | プローブを使う前の儀式 |
| 60 | 熱容量の大きなランドの場合② 熱風による方法 | 135 | プローブのグラウンドの取り方 |
| 61 | 小さいチップ部品の取り付け方 | 136 | プローブの共振対策 |
| 62 | 大きいチップ部品の取り付け方 | 137 | グラウンドとAC電源の関係&疑似差動 |
| 63 | ユニバーサル基板への取り付け方 | 138 | 電流波形の測定方法 |
| 64 | 表面実装タイプのネットワーク抵抗の取り付け方 | 139 | デジタル・マルチメータの精度 |
| ICやトランジスタ | | 実際に電源回路を例に出力波形を観測してみる | |
| 65 | 3端子タイプの半導体の取り付け方 | 140 | 使用する測定器の説明 NEW |
| 66 | 放熱板付き半導体の取り付け方① プリント基板の場合 | 141 | テスタで直流電圧測定 NEW |
| 67 | 放熱板付き半導体の取り付け方② ユニバーサル基板の場合 | 142 | プローブの補正 NEW |
| 68 | リード・タイプのICの取り付け方 | 143 | オシロスコープで出力電圧の測定① 長いプローブGND NEW |
| 69 | 表面実装タイプのICの取り付け方 | 144 | オシロスコープで出力電圧の測定② 短いプローブGND NEW |
| 70 | 裏に放熱板がある表面実装タイプICの取り付け方 | 145 | 番外編 USB電源アダプタのノイズ NEW |
| コネクタ&特殊部品 | | おまけ ベテランの電子回路製作(電源回路を例に) | |
| 71 | ピン・ヘッダの取り付け方 | 146 | スベックを決め方 NEW |
| 72 | ポリウレムの取り付け方 | 147 | 回路方式の検討 NEW |
| 73 | リード・タイプのコネクタの取り付け方① ネジ留めがある場合 | 148 | 回路図の見方 NEW |
| 74 | リード・タイプのコネクタの取り付け方② 熱容量の大きい端子 | 149 | 部品表の作り方 NEW |
| 75 | 表面実装タイプのコネクタの取り付け方 | 150 | 基板設計エンジニアに渡す回路図の描き方 NEW |

*本ムービーは2016~2018年の付録DVD-ROMの動画を再編集しています。 **NEW** は新たに追加したムービーです

電気の単位

OPAMP&アナログ回路 回路シミュレーション

プリント基板製作

測定器の使い方

規格